

セミアディティブ法対応 LCPフィルムへの無電解銅めっきプロセス

トップLECSプロセス

Electroless Copper Plating Process to LCP Films Applicable for SAP

TOP LECS PROCESS

- 高周波高速伝送に適したLCPフィルムへのめっきが可能
- 全工程湿式プロセスであり、Roll to Roll処理により両面を一括でメタライズ可能
- セミアディティブプロセスに対応
- 優れた密着性が得られる

- Realize plating to LCP films suitable for high-frequency, high-speed transmission
- All steps : Wet process
- Metallizing both sides at once by Roll to Roll treatment
- Applicable for SAP
- Excellent in adhesion

全工程湿式プロセス

All steps:Wet process



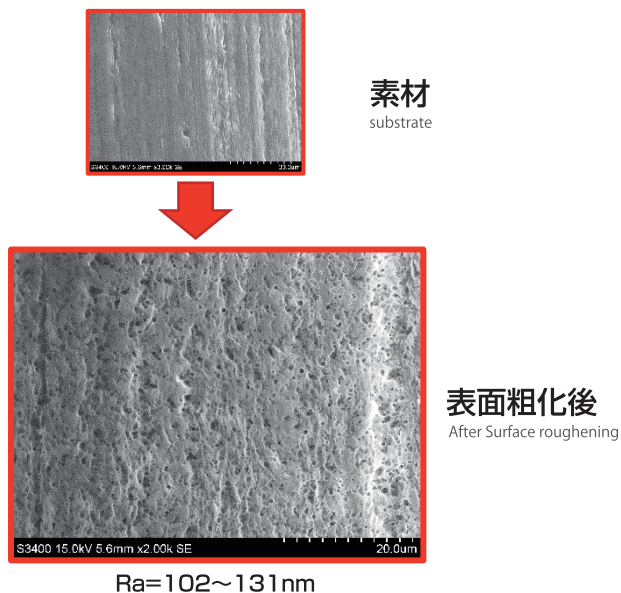
トップLECSプロセス処理工程

LCPフィルムに直接無電解銅めっきが可能

TOP LECS PROCESS, Treatment process
Realize direct electroless plating on LCP films

高速伝送に適した低粗化プロセス

Process for low Ra materials, suitable for high-speed transmission



パラジウム吸着量が低い

Low palladium concentration

	パラジウム吸着量 Palladium adsorption amount
LCPフィルムA LCP filmA	11 $\mu\text{g}/\text{dm}^2$
LCPフィルムB LCP filmB	14 $\mu\text{g}/\text{dm}^2$
ポリイミド Polyimide	17 $\mu\text{g}/\text{dm}^2$

パラジウム吸着量が低く
パターンニング性に優れる

Reduce palladium adsorption amount,
excellent in pattern forming performance

優れた密着強度

Excellent in adhesion strength

